

Mate 2006 第12回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」 シンポジウム論文募集について

主 催：(社) 溶接学会 マイクロ接合研究委員会

共 催：(社) 高温学会 加工・再生研究情報委員会、
(社) 機械学会 エレクトロニクス実装における信頼性
設計と熱制御に関する研究分科会、(社) 日本塑性加工
学会 接合・複合分科会、エレクトロニクス生産科学
学会準備会、レーザ加工学会、大阪大学 先端科学イ
ノベーションセンター

協 賛：映像情報メディア学会、エレクトロニクス実装
学会、応用物理学会、化学工学会、画像電子学会、軽
金属学会、計測自動制御学会、高温学会、高分子学会、
資源・素材学会、システム制御情報学会、情報処理学
会、人工知能学会、精密工学会、電気化学会、電気学
会、電気設備学会、電子情報通信学会、日本化学会、
日本機械学会、日本金属学会、日本材料学会、日本シ
ミュレーション学会、日本接着学会、日本セラミック
ス協会、日本塑性加工学会、日本顕微鏡学会日本伝熱
学会、日本非破壊検査協会、日本表面科学会、日本品
質管理学会、日本複合材料学会、日本物理学会、日本
分析化学会、日本溶接協会、表面技術協会、プラスチ
ック成形加工学会 (協賛依頼中)

日 時：平成18年2月2日(木)、3日(金)

パシフィコ横浜 会議センター
5階(小ホール、501、502)
横浜市西区みなとみらい1丁目1-1
TEL: 045-221-2121

開催主旨

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムでは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

参加費：主催・共催団体加入会社：20,000円
協賛学協会会員会社：30,000円
論文口頭発表者：15,000円
大学・国公立研究機関：10,000円
学 生：5,000円
その他：40,000円

講演論文募集

左記主旨に従い、シンポジウムを開催いたします。つきまして、独創性に富むオリジナル講演論文を募集しております。各講演の発表時間は20分(発表12分、質問8分)、発表件数は約90件を予定しております。投稿希望の方は下記の送り先まで、応募していただくようお願い申し上げます。

なお、本シンポジウムで発表されたすべての論文発表者には、別刷り30部を無料贈呈します。また、優秀な論文に対して、シンポジウム賞(論文賞、奨励賞)の表彰制度も用意しております。

応募締切：平成17年9月1日(木) 厳守

応募方法：次の必要事項を記載して、E-mail、FAX、郵送のいずれかでMate 2006 事務局に送付して下さい。

E-mail を利用できる方はできるだけE-mailで送付していただけますようお願いいたします。

- (1) 発表題目(和文と英文)
- (2) 著者名と所属先(和文と英文)
- (3) 著者代表者の連絡先
- (4) 概要(和文120~150字程度)
- (5) トピックス記号(カテゴリー A~Cの中から該当する記号を選んで下さい)

例えば、

レーザによる微細加工プロセスに関する研究

→ A-5, B-1

携帯機器創成を目的としたソルダリング部の信頼性の研究 → A-2, B-7, C-6

申込みを受理した後1週間以内にE-mailもしくはFAXで受理通知を送付させていただきます。

受理通知が届かない場合は、Mate 2006 事務局にご確認して下さい。

また、論文採択につきましては別途、採択通知を9月末までに送付いたします。

論文原稿送付締切日：平成17年11月18日(金)

論文様式概要

本文は日本語で、Figure Captionは英語で記述する。ただし、すべて英語で記述しても結構です。

○字 体：英語の字体(フォント)はTimes、日本語の字体は明朝体とする。

○題 目：本文が日本語の場合、日本語と英語(字サイズ：14 point、題目の字体は等幅明朝体またはゴシック体とする)。

○著 者 名：本文が日本語の場合、日本語と英語(字サイズ：9 point)。

○ Abstract：英語(60~120 words)
(字サイズ：8 or 9 point)。

- 本文：日本語または英語
 （字サイズ：9 point），本文二段組。
 ○マージン：上：25mm，下左右：20mm。
 ○用紙：A4 白用紙。
 ○図の説明：英語（図面は本文の後ろに並べてもよい）。
 ○ページ数：4 ページまたは 6 ページ（奇数ページでの仕上がりは禁止する）。
- なお，論文採択決定後，詳しい投稿規定を送付します。

<論文に関する問合せ先>

大阪大学 先端科学イノベーションセンター 高橋康夫
 Tel: 06-6879-4195 Fax: 06-6879-4193
 E-mail: takasy@crcast.osaka-u.ac.jp

<論文の送付先，事務に関する問合せ，連絡先>

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町 1-11
 （社）溶接学会 Mate 2006 事務局

Mate 2006 担当連絡先

TEL: 06-6879-4166 FAX: 06-6879-4166

E-mail: mate@casi.osaka-u.ac.jp

<シンポジウム URL>

[http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate 2006.html](http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate%2006.html)

トピックス記号

カテゴリーA 工 法		カテゴリーB 研究・開発の観点		カテゴリーC 対象形態・製品	
A- 1	マイクロ接合	B- 1	プロセス	C- 1	パッケージ（IC・LSI）
A- 2	マイクロ溶ダリング	B- 2	材料	C- 2	モジュール
A- 3	ナノプロセッシング	B- 3	機能特性		（SiP・SOC，etc）
A- 4	薄膜形成	B- 4	メカニズム	C- 3	パワーデバイス
A- 5	厚膜形成（めっきなど）	B- 5	拡散現象	C- 4	エネルギー変換素子
A- 6	ビーム加工	B- 6	界面構造	C- 5	エネルギー変換機器
A- 7	エッチング	B- 7	信頼性	C- 6	通信機器
A- 8	マイクロ加工	B- 8	品質	C- 7	携帯機器
A- 9	塑性加工	B- 9	解析・シミュレーション	C- 8	コンピュータ・周辺機器
A-10	接着	B-10	設計・システム	C- 9	ディスプレイ
A-11	光・電子アセンブリ	B-11	設備・機器	C-10	カーエレクトロニクス
A-12	光インターコネクション	B-12	検査・評価	C-11	医療・バイオ製品・機器
A-13	その他	B-13	生産管理・マネジメント	C-12	MEMS
		B-14	計測	C-13	航空宇宙・車両
		B-15	環境調和・リサイクル	C-14	回路・部品内蔵基板
		B-16	生産戦略・企画事業化	C-15	その他
		B-17	その他		